

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-76

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	天弘基金、东吴证券、UBS
上市公司接待人员	投资者关系经理：郭家旭
时间	2024年12月17日
地点	网络及电话会议
形式	线上交流
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。</p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。</p> <p>Q2、请介绍 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。</p> <p>伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，新一代信息技术产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求均受到上述趋势的影响。</p> <p>Q3、请介绍公司是否具备 HDI 工艺技术能力。</p>

	<p>HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。</p> <p>Q4、请介绍公司 PCB 业务今年前三季度在数据中心领域的布局拓展情况。</p> <p>数据中心是公司 PCB 业务重点布局领域之一，聚焦服务器、存储及周边产品。2024 年前三季度，全球主要云服务厂商资本开支规模明显回升，并重点用于算力投资，带动 AI 服务器相关需求增长，叠加通用服务器 Eagle Stream 平台迭代升级，服务器总体需求回温。在此期间，公司数据中心领域订单同比显著增长，主要得益于 AI 加速卡、Eagle Stream 平台产品持续放量等产品需求提升，产品结构有所优化。在新产品预研方面，公司已配合下游客户开展下一代平台产品研发、打样工作。</p> <p>Q5、请介绍公司在封装基板领域的产品布局情况。</p> <p>公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力。另一方面，针对 FC-BGA 封装基板产品，公司通过近年来持续的技术研发工作，已实现部分产品的技术能力突破，相关客户认证及产能建设工作取得进展。目前，公司已成为内资最大的封装基板供应商。</p> <p>Q6、请介绍广州封装基板项目连线爬坡进展。</p> <p>公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年持续快速提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作，其认证周期相较其他 PCB 及封装基板产品所需时间更长。</p> <p>Q7、请介绍公司近期产能利用率情况。</p> <p>公司近期综合产能利用率较 2024 年第三季度保持平稳。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>

附件清单	无
------	---